DEXQUARE

www.dexquare.com
instagram.com/dexquare

DESIGN
YOUR SQUARE



TC & POSCO

덱스퀘어는 TC의 소속이자 POSCO의 합작 기업입니다.

덱스퀘어가 상품 제조, 디자인 패턴 개발, R&D 기능성 제품 개발 등을 관리하고 POSCO에서 원자재 공급과 기술력을 제공하여, 덱스퀘어는 토탈솔루션 프로바이더 역할을 완수할 수 있게 되었습니다. 또한 국내의 건설 산업과 인테리어 등의 신규 시장 개발과 함께 세계로 수출하는 전문 건자재 기업입니다.

DEXQUARE

- Construction products Manufacturing
- Various design Development
- Sales, Marketing
- R&D(Functional, Customized)

POSCO

- Operating open platform
- Stable raw material supply
- Sales, Marketing
- R&D(Raw materials)

TC & POSCO Joint venture DEXQUARE

DOMESTIC SALES

New Market Development
Construction, Interior, etc

EXPORT

New Market Development
USA, Europe, Vietnam, etc





DEX-BOARD

덱스보드는 기존 강판 시공의 어려움을 개선하여
쉬운 작업성과 **기능성**을 제공하는 토탈 솔루션 상품입니다.

PRODUCT CHARACTERISTIC

| 상품 특성

1440 dpi의 해상도에 질감 연출이 가능하며, 세라믹 성분 80% 이상의 특수 세라믹 도료로 코팅하여 대리석, 페인트, 벽지, 타일 대신 사용할 수 있으며 내·외장재 모두 적용 가능합니다. 고객 요청에 따른 디자인 반영이 가능하여 나만의 공간을 만드는데 탁월한 제품입니다.



커스터마이징 디자인
우수한 평활도 | 자석 부착 가능 | 고객 요청 디자인 제작



간편한 유지관리
수건 청소



간단한 시공법
양생 없는 1일 시공



기능성 강판
K.S 불연인증 획득 | 높은 표면 경도 (3H 이상) | 자가세정 기능 (유성매직 제거)

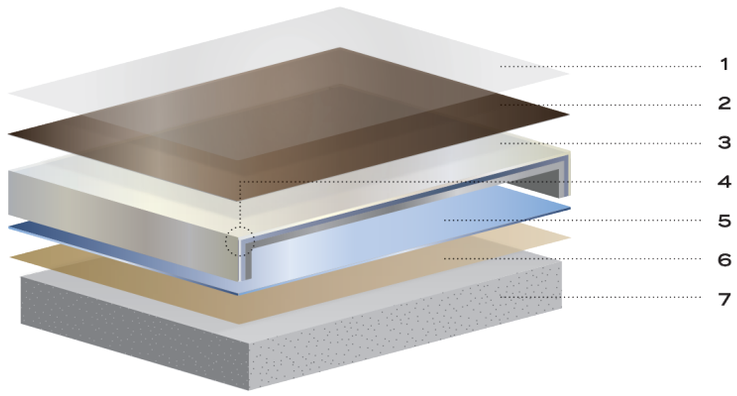
MATERIAL: PosMAC

원소재: 포스맥

동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI) 대비 5~10배 이상의 내식성을 보유한 제품으로, 특히 절단면의 내식성이 매우 우수합니다.

SPECIFICATION

| 제품 사양



	STRUCTURE	CONTENTS	THICKNESS
1	Protective Film	Low-Density Polyethylene	100㎛
2	Printing	Ceramic	10㎛
3	POSMAC	POSMAC	0.4~2mm
4	Edge Area	2~4 Radius	
5	Back-Printing	Ceramic	2 - 3㎛
6	Adhesive	Eco-friendly Adhesive	50㎛
7	Back Side Material (Filler)	Gypsum board / MDF / Honeycomb (Al, Paper)	9.5mm

DEXQUARE CONSTRUCTION APPLICATION

RESIDENTIAL AREA

Kitchen (Board / Cabinet / Hood)
Door (Sliding Door / Hinged Door / Fire Door)
Bathroom
Bedroom
Living room

COMMERCIAL AREA

Elevator (Art wall / Door)
Hallway wall board
Partition (Office Cubicle / Restroom Cubicle)
Exterior material panel

ART FRAME

METAL CEILING






.9
24










BEKKO




GUEST




LADIES


HANUP
Special & Mold steel
Construction Machinery
佰財聚來




1
8

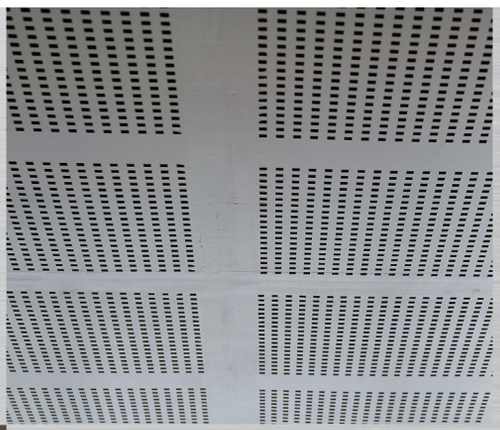


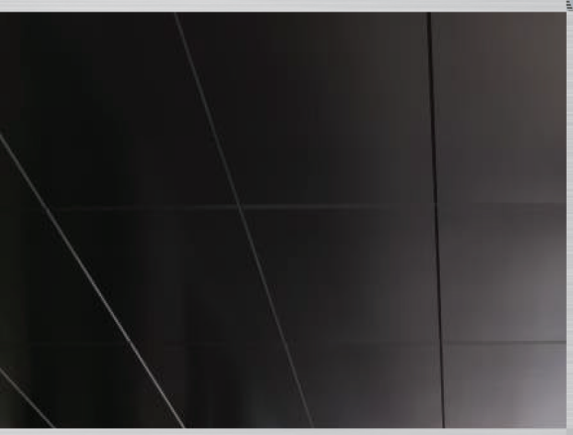


GRAPHICS TECHNOLOGY IMPLEMENTATION











METAL CEILING

TEST RESULTS

| 인증 및 성적서

기능성 인증서


시험성적서


시험성적서

불연 인증서


시험성적서

항균 인증서


시험성적서

DEX-BOARD CONSTRUCTION

| 덱스보드 시공 방법

STEP 1. 시공 현장 조건 세팅	온도 21~25℃ / 습도 40~70% / 조건유지 40h / 벽함수율 5% 이하
STEP 2. 수평 및 절단	레이저 레벨기를 활용하여 벽면의 수평과 수직 설정
STEP 3. 절단	디자인에 맞는 사이즈로 절단
STEP 4. 접착제로 보드 고정	접착제(실리콘)를 이용하여 벽면에 보드 부착
STEP 5. 시공 완료	시공 완료 후 마감 몰딩, 천장 몰딩 등 마감재 설치